



Skew Lot Wafers 测试项目

1. 测试芯片 Wafers : TT, FF, SS (B2 & B3)

2. TX 基本性能: (HJP)

Power & EVM & Mask & IQ-Mismatch & DC-leakage

信道: 1~14

速率: 1M, 11M, 6M, 54M, MCS0, MCS7, MCS7_40

3. RX 基本性能 (HJP)

RX 灵敏度 & 最大接收电平

信道: 1~14

速率: 1M, 11M, 6M, 54M, MCS0, MCS7, MCS7_40

RX 接收动态范围

信道: 1, 6, 11, 14

速率 & 范围: 1M -> [-99:0], MCS7 -> [-74:0]

4. TX / RX 电流 (HJP)

5. 邻道抑制 (HJP)

6. RX Gain (CFF)

RX Gain Table: 14 信道

RFRX Force Gain: 14 信道

LNA / VGA DCAP 对 RFRX Gain 的影响

7. RFPLL (CFF)

CAP & DAC 校准值

8. Power Detect 线性度测试 (ZAQ)

9. I2C 配置 (ZAQ)



10. B3 常温 RFPLL UNLOCK 问题 (QZ)

11. B2 & B3 高温 RFPLL UNLOCK 问题 (QZ)

12. PA2G_VCT_CSC_STG0 的异常现象 (QZ)

PA2G_VCT_CSC_STG0 值越大，在发送较大功率，约 26dm 以上时，有的模组会发生 POWERON_RESET。

13. 认证问题 (QZ)

传导 & 辐射：800M，3.2G，4.8G，9.6G 杂散

14. 高低温 (QZ)

I2C 模块读写时钟

INIT CAL Print

CONFIDENTIAL